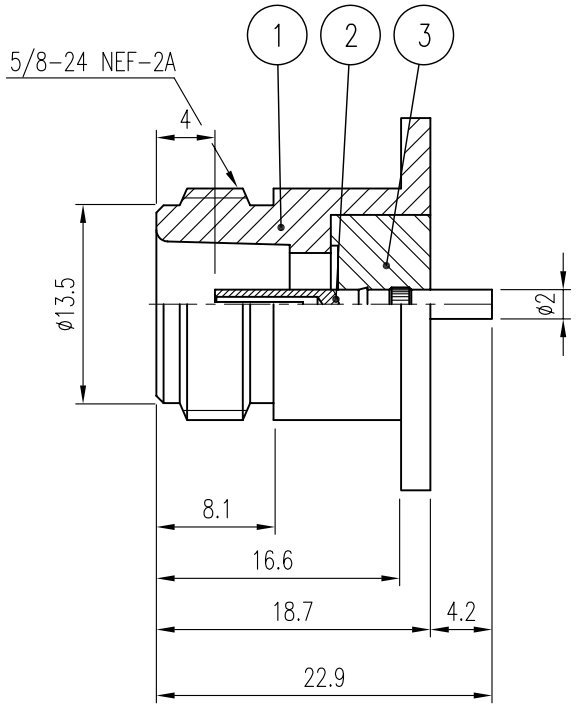
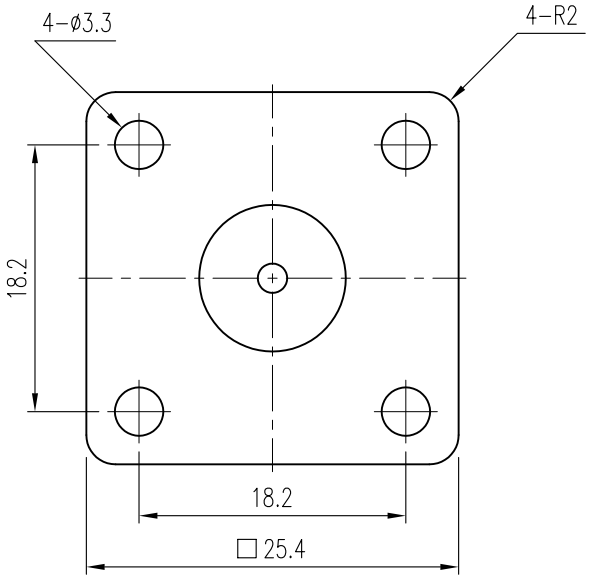
ST \ 기공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00766-N/1 (H8532)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00800-5/1 (E8530)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01001-5/1 (D8532)

주 기

1. 조립시 BODY 플랜지 면에서 절연체가 돌출되지 않도록 할 것.

대체가능재질	품번	품 명	수량
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2004. 4. 30.	
	승인		
재질	검도		
	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	
보호피막처리	척도 1.5/1	단위 mm	중량 —

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 N75-J-H4-R

A4

도번 CN00845-7/1

K347-411-000